

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 7 月 13 日 (2006.7.13)

【公開番号】特開 2001-75628 (P2001-75628A)

【公開日】平成 13 年 3 月 23 日 (2001.3.23)

【出願番号】特願 平 11-247464

【国際特許分類】

G 0 5 B 19/418 (2006.01)

B 2 3 Q 41/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

【F I】

G 0 5 B 19/418 Z

B 2 3 Q 41/08 Z

H 0 1 L 21/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 5 月 31 日 (2006.5.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、

上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、

上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電氣的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、

上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において、

上記機器制御システムは、上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納し、

上記機器制御システムは、上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを、上記パラメータの組の優先度に応じて上記メモリに展開することを特徴とする、半導体製造装置。

【請求項 2】 半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、

上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、

上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電氣的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、

上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において装置動作条件パラメータを管理する方法であ

って、

上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納する工程と、

上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程とを具備することを特徴とする方法。

【請求項 3】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の高いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータが上書きされるように、次に優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項 2 記載の方法。

【請求項 4】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の低いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の低いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、次に優先度の低いレベルのパラメータの組の中で既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータ以外のパラメータを上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項 2 記載の方法。

【請求項 5】 半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、

上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、

上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電氣的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、

上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において、

上記装置動作条件パラメータを管理する動作をコンピュータにさせるプログラムを記録した記録媒体であって、

当該プログラムは、

上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納する工程と、

上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程とを具備することを特徴とする記録媒体。

【請求項 6】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の高いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータが上書きされるように、次に優先度の高いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項 5 記載の記録媒体。

【請求項 7】 上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は、

最も優先度の低いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の低いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、次に優先度の低いレベルのパラメータの組の中で既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータ以外のパラメータを上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする請求項５記載の記録媒体。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００１４

【補正方法】変更

【補正の内容】

【００１４】

請求項４に記載された本発明の装置動作条件パラメータの管理方法によれば、上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程は

、
最も優先度の低いレベルのパラメータの組を上記メモリに展開する工程と、

次に優先度の低いレベルのパラメータの組が上記記憶装置から取得できなくなるまで、次に優先度の低いレベルのパラメータの組の中で既に上記メモリに展開されたパラメータと同じ項目のパラメータ以外のパラメータを上記メモリに展開する工程とを有することを特徴とする。

請求項５に記載された本発明の記録媒体は、半導体製造プロセスを実行する少なくとも一つの処理チャンバを含む処理システムと、上記処理システムの上記処理チャンバに処理対象物を出し入れする搬送システムと、上記処理システム及び上記搬送システムの機械制御部に電氣的に接続され、装置制御プログラム及び装置動作条件パラメータを格納する記憶装置を有し、上記機械制御部に上記装置制御プログラム及び上記装置動作条件パラメータを供給する機器制御システムとにより構成され、上記機械制御部は上記機器制御システムから供給された上記装置制御プログラム及びメモリに展開された上記装置動作条件パラメータに基づいて上記処理システム及び上記搬送システムを制御する半導体製造装置において、上記装置動作条件パラメータを管理する動作をコンピュータにさせるプログラムを記録した記録媒体であって、当該プログラムは、上記装置動作条件パラメータを、上記半導体製造装置に固有の標準的なレベルから上記半導体製造装置のユーザに固有の特殊なレベルまでの優先度を付けられたレベル毎に上記記憶装置に格納する工程と、上記機器制御システムの上記記憶装置に格納された上記装置動作条件パラメータを上記パラメータの組の優先度の順番に上記メモリに展開する工程とを具備することを特徴とする。